

深控系列 RU6G RU6GM

用途:一般用於手機硬板、軟硬複合板、BGA、IC載板、嵌入式需求電路板等深控成型。



自動換刀
刀長補償
裝置

獨立Z軸搭配
光學尺偵測
板厚,提升
深控加工精度

選配跨軸
成型功能

真空檯面
裝置提升
深控精度

盲撈加工
切面
或撈殘厚

全行程控制
加工深度
加工完後
可匯出板材
量測數據

CCD系列 RU1A-BC RU2HL RU6H2 RU6HM

用途:一般用於PCB 光模塊、mini LED板、載板、伺服板、車用PC板、通訊板加工等高精度CCD對位成型。



CCD功能
各軸X、Y獨立
補償校正

真空吸盤檯面
上下料快速
克服板材彎曲

Z軸獨立控制

配合Z軸光學尺
及板厚偵測
光學尺,可執行
成型深度補償

CCD取樣精度
 $\pm 0.005\text{mm}$
(大量條件)

機 型	RU6G	RU6GM	RU1A-BC	RU2HL	RU6H2	RU6HM
主軸軸數	6	6	1	2	6	6
加工範圍	560×680mm	655×840mm	609×684mm	667×795mm	560×680mm	626×808mm
真空有效範圍	528×648mm	615×777mm	572×672mm	632×779mm	528×648mm	555×790mm
主軸型式/轉速	滾珠軸承 / 15,000rpm ~ 60,000 rpm 空氣軸承 / 15,000rpm ~ 80,000 rpm(選配)					
伺服系統	X、Y軸AC伺服馬達； Z軸各軸獨立AC伺服馬達	X、Y軸線性馬達； Z軸各軸獨立AC伺服馬達	X、Y軸AC伺服馬達； Z軸各軸獨立AC伺服馬達	X、Y軸獨立AC線性馬達；Z軸各軸獨立AC伺服馬達	X、Y軸線性馬達； Z軸各軸獨立AC伺服馬達	
移動速度	X、Y、Z軸 30m/min	X、Y軸 60m/min； Z軸 30m/min	X、Y、Z軸 30m/min	X、Y軸 60m/min；Z軸 30m/min		
定位精度	±0.004mm					
外型成型精度	±0.05mm(大量科技條件)					
深控精度	探尺方式：± 0.03mm (大量科技條件) CBD方式：±0.015mm (大量科技條件)					
CCD取樣精度				±0.005mm		
CCD取樣範圍				4 × 4 mm		
換刀系統	300把自動換刀					
刀具偵測裝置	接觸式刀長量測+非接觸式刀徑量測+即時斷刀偵測					
檯面型式	真空吸盤+頂出脫料系統					
適用刀具尺寸	銑刀：Ø0.5mm~Ø3.175mm 鑽刀：Ø0.5mm~Ø6.35mm					
外型尺寸 (mm) (L×W×H)	4,524x2,000x2,188	4,685×2,100×2,260	1,600×2,038×2,291	2,574×2,256×2,214	4,569×2,096×2,415	4,700×2,160×2,300
機台總重 (kg)	8,450	10,000	2,650	6,000	10,000	13,600
設備電力規格	3Ø、AC 220V 50/60Hz					
電源功率	15 KVA (Avg. 10~12.5 KVA)		5 KVA (Avg. 3~4.2 KVA)	10 KVA (Avg. 5~6.5 KVA)	20 KVA (Avg. 10~12.5 KVA)	30KVA (Avg. 10~12.5KVA)
冷卻要求	水溫18~22℃					
壓縮空氣需求	6.5Kg / cm ² 以上					
操作環境需求	加工環境23±3℃，相對溼度75%以下					

◎本型錄僅供參考, 以實際規格為準。